

Die Anmeldung erfolgt über **ConfTool**:
www.conftool.net/imaps-herbstkonferenz-2024

Für den Nachweis der Mitgliedschaft bei IMAPS-Deutschland tragen Sie bitte Ihre Mitgliedsnummer in das Registrierungsformular ein.

TEILNAHMEGEBÜHREN:

- € 230,- IMAPS-Mitglieder
- € 325,- Nichtmitglieder
- € 90,- Vortragende
- € 40,- Studierende

Die Bezahlung der Teilnahmegebühr erfolgt gegen Rechnung.

In der Teilnahmegebühr sind die Tagungsunterlagen, der Pausenkaffee und die Teilnahme an der Abendveranstaltung im Augustiner enthalten. Die Gebühren sind gemäß § 4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei.



ANREISE MIT DER BAHN U. ÖPNV

Von München Hauptbahnhof fahren Sie mit der Tram 20 Richtung Moosach oder 21 Richtung Westfriedhof bis zur Haltestelle Lothstraße.



INFORMATIONEN + RESERVIERUNG FÜR AUSSTELLUNG:

Ernst Eggelaar, MBA
 Tel.: +49 8722/9620-0
 E-Mail: info@imaps.de



Deutsche IMAPS-Konferenz 2024

Herbstkonferenz
17.-18.10.2024

Bitte melden Sie sich über unsere Internetseite an!

www.imaps.de



Begleitende Ausstellung

Stand ca. 6 m². Mögliche Ausstattung (bitte mit Anmeldung übermitteln):

- **Tisch** (ca. 120x80 cm) und 2 Stühle
- **Pinwand** (ca. 120x120 cm)
- **230 V-Anschluss**

PREIS: € 980,-

Der Preis beinhaltet neben dem Stand auch die Teilnahme an der Konferenz und der Abendveranstaltung für 2 Personen.

ANMELDUNG

Sie können sich nur über unsere Internetseite als Aussteller registrieren.

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Anmeldungen zur Ausstellung werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt!

WEITERE VERANSTALTUNGEN:

The 46th IMAPS Poland Conference , 22.-25. September 2024, Qubus Hotel Gdańsk, Poland;
<https://imaps2024.eti.pg.gda.pl/index.php>

IMAPS Symposium 2024, 1. - 3. Oktober 2024. Boston, USA
<https://imaps.org/page/IMAPS2024>

Hochschule München
 Munich University of Applied Sciences
 Lothstr. 64
 D-80335 München

AB 08:00 UHR EINSCHREIBUNG UND GET-TOGETHER IM FOYER**09:00 – ERÖFFNUNG UND BEGRÜßUNG**

09:10 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM | IMAPS*

09:10 – EMERGING TECHNOLOGIES 1

10:25 Ort: Hörsaal
Chair: Indira Käpplinger, *CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH | IMAPS*

09:10 Innovationscampus Elektronik und Mikrosensorik (iCampus) - Strukturwandel in der Lausitz

Christine Ruffert, Michael Scholles
Fraunhofer IPMS / BTU-CS

09:35 Herstellung hochfester Drucksensoren mithilfe innovativer Silizium-Keramik Technologie (SiCer)

Cathleen Kleinholz¹, Michael Fischer¹, Andrea Cyriax², Michael Hintz², Thomas Ortlepp², Jens Müller¹
¹*Technische Universität Ilmenau;*
²*CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH*

10:00 Technologiestudie zur Dünnschichtstrukturierung auf LTCC-Substraten mittels Lift-Off-Verfahren

Uwe Ziegler, Heike Bartsch, Jens Müller
Technische Universität Ilmenau

10:25 – VORSTELLUNG DER AUSSTELLER

10:45 Ort: Hörsaal

10:45 – AUSSTELLUNG UND KAFFEPAUSE

11:30 Ort: Foyer

11:30 – SINTERN UND BONDEN

12:50 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM | IMAPS*

11:30 Überblick zu Testmethoden beim Drahtbonds

Bernhard Rebhan, Johann Enthammer, Josef Sedlmair
F&S Bondtec Semiconductor GmbH, Österreich

11:50 Thermomechanische Zuverlässigkeit von Aluminium Bonddrähten leistungselektronischer Bauteile

Borja Kilian¹, Youssef Maniar¹, Jonas Gleichauf¹, Olaf Wittler², Martin Schneider-Ramelow³
¹*Robert Bosch GmbH;* ²*Fraunhofer IZM;* ³*TU Berlin*

12:10 Physics-of-Failure Based Lifetime Modelling of Silver Sintered Power Modules for Electric Vehicles by Experiment and Simulation

Freerik Forndran¹, Jens Heilmann², Markus Leicht¹, Bernhard Wunderle²
¹*Vitesco Technologies Germany GmbH;* ²*TU Chemnitz*

12:30 Low Temperature Die-attach Bonding Using Cu Complex based Materials for Power Electronics

Nihesh Mohan, Gordon Elger
Institute of Innovative Mobility, TH Ingolstadt

12:50 – MITTAGSPAUSE UND AUSSTELLUNG

13:45 Ort: Foyer

13:45 – LED UND LIDAR

15:00 Ort: Hörsaal
Chair: Artem Ivanov, *University of Applied Sciences Landshut | IMAPS*

13:45 Hardware-in-the-Loop Prüfstand zur beschleunigten Alterung und Charakterisierung von Automotive LiDAR-Sensoren als Grundlage für eine Zustandsüberwachung im Feld

Marcel Kettelgerdes^{1,2}, Hüseyin Erdogan³, Bernhard Wunderle⁴, Gordon Elger^{1,2}
¹*TH Ingolstadt;* ²*Fraunhofer IVI;* ³*Conti Temic Microelectronic GmbH;* ⁴*TU Chemnitz*

14:10 LED Lifetime Prediction - Automatic Feature Extraction from FEA Data Using Convolutional Neural Network (CNN)

Mohd Zubair Akhtar, Andreas Zippelius, Maximilian Schmid, Gordon Elger, *TH Ingolstadt*

14:35 SMT Processing - Challenges CSPs LEDs

Kurt-Jürgen Lang, *ams OSRAM International GmbH*

15:00 – AUSSTELLUNG UND KAFFEPAUSE

15:35 Ort: Foyer

15:35 – EMERGING TECHNOLOGIES 2

16:50 Ort: Hörsaal
Chair: Matthias Lorenz, *AEMtec | IMAPS*

15:35 Parylene als neues Material für die Systemintegration

Franz Selbmann^{1,2}, Martin Kühn^{1,2}, Frank Roscher¹, Maik Wiemer¹, Yvonne Joseph²
¹*Fraunhofer ENAS;* ²*TU Bergakademie Freiberg*

16:00 Individuelle Packages für Hochfrequenz Anwendungen

Maximilian Barth, Wolfgang Eberhardt, Kai Werum
Hahn-Schickard

16:25 Towards Chiplets in Harsh Environments: Advanced packaging is the focus for chiplets

Torsten Grawunder, *Swissbit Germany AG*

17:00 – MITGLIEDERVERSAMMLUNG

18:00 Ort: Hörsaal
Chairs: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM/IMAPS,* Ernst J. M. Eggelaar, *Microtronic M. V. GmbH | IMAPS*

Ab GEMEINSAMES ABENDESSEN IN DEN

19:30 AUGUSTINER GASTSTÄTTEN
Neuhauser Str. 27, 1. OG, Grüner Saal

Freitag 18.10.2024

09:00 – DICKSCHICHT-TECHNOLOGIEN

10:40 Ort: Hörsaal
Chair: Jens Müller, *TU Ilmenau | IMAPS*

09:00 Entwicklung von Widerstandspasten und -tinten für das Greentape 9K7

Manja Marcinkowski¹, Stefan Körner¹, Frederike Kramer²,
¹*Fraunhofer IKTS;* ²*SurA Chemicals GmbH*

09:25 In Dickschichttechnik hergestellter Probenträger zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit, der Hall-Konstante und des Seebeck-Koeffizienten bis 800 °C
Jaroslaw Kita, Robin Werner, Ralf Moos
Universität Bayreuth

09:50 Kostengünstige, unedle Dickschichtpasten für Sensoren und Energiewandler
Stefan Körner¹, Kathrin Reinhardt¹, Claudia Feller¹, Andrzej Dziedzic², Szymon Wójcik², Mirosław Gierczak²
¹*Fraunhofer IKTS;* ²*Wroclaw University of Science and Technology - WUST, Poland*

10:15 Hochauflösende Leiterzüge unterhalb 50 µm Linienbreite durch Laserdirektanschreibverfahren für mmWave-Anwendungen
Lynn Ratajczak¹, Kiana Karimi², Kathrin Reinhardt¹, Heike Bartsch², Martin Ihle¹
¹*Fraunhofer IKTS;* ²*Technische Universität Ilmenau*

10:40 – AUSSTELLUNG UND KAFFEPAUSE

11:30 Ort: Foyer

11:30 – PCB-TECHNOLOGIEN

12:45 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM | IMAPS*

11:30 Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Kupfer-Durchkontaktierungen in Leiterplatten mittels Zugversuch und Nanoindentation
Janine Conrad¹, Martin Schneider-Ramelow¹, Olaf Wittler²
¹*TU Berlin;* ²*Fraunhofer IZM*

11:55 THT-Löcher fertigungsgerecht auslegen – Lötqualität und Prozessrobustheit steigern
Reinhardt Seidel¹, Markus Hermann², Ulrich Wittreich^{2,4}, Jörg Franke¹
¹*Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,* ²*SIEMENS AG*

12:20 Innovative Einbettungstechnologien zur Miniaturisierung und Leistungssteigerung elektronischer Systeme
Dincer Sirkeci, *Fraunhofer IZM*

12:45 – SCHLUSSWORT UND AUSBLICK

13:00 Ort: Hörsaal
Chair: Martin Schneider-Ramelow, *Fraunhofer IZM | IMAPS*